

日時

# 2018年 10月5日 金 13:30-18:30

アランヴェールホテル京都 五条の間/嵯峨・貴船の間

〒600-8107 京都府京都市下京区東錺屋町179

## 講師



赤松 憲樹 氏 工学院大学 先進工学部 環境化学科 准教授 「膜を利用した微粒子分級技術を紹介します」



吉田 幹生 氏 同志社大学 理工学部 化学システム創成工学科 准教授 「微小粒子添加で粒子流動性を向上させよう!」



辻 拓也 氏 大阪大学 工学研究科 機械工学専攻 准教授 「粉体挙動を"見える化" したくないですか?」

### ベストシーズ講演会とは...「APPIE 産学官連携フェア」にて人気の高かったシーズを集めた講演会です。

一般社団法人日本粉体工業技術協会 産学技術交流推進部門では、大学や公的研究機関が保有している粉体技術にかかわるシーズ(研究)と企業の方々のニーズとマッチングさせる出会いの場として「APPIE産学官連携フェア」を隔年で開催しております。今回のベストシーズ講演会では、「APPIE 産学官連携フェア2017」で発表されたシーズの中から参加者投票により選ばれる「日本粉体工業技術協会奨励賞 技術シーズ賞」を受賞されたシーズ発表者3名を講師としてお招きして、「APPIE 産学官連携フェア」

粉体技術に興味のある方ならどなたでも参加できますので、奮って参加いただきますようご案内いたします。

#### 参加申込要領

日 時:2018年10月5日(金)13:30~18:30

場 所: アランヴェールホテル京都 五条の間 / 嵯峨・貴船の間 https://www.aranvert.co.jp/access/ 〒600-8107 京都府京都市下京区東錺屋町179 TEL 075-365-5111

京都市営地下鉄五条2番出口から直進 徒歩2分

参加費: 会員 1,000 円 一般 2,000 円(消費税・資料代・懇親会参加費を含む)

で発表いただいたシーズについて、より深いところまでお話しいただきます。

定 員:50名

申込締切日:10月1日(月)(定員になり次第、締め切り)

申込方法:日本粉体工業技術協会のホームページ上からお申込ください。

申込受付後、「受理書」をE-mail送信いたします。

https://www.appie.or.jp/FS-APL/FS-Form/form.cgi?Code=seeds

支払方法:参加費は別途郵送する請求書に記載の口座へ10月4日(木)までに お振込み下さい。9月1日からは、クレジット決済もご利用可能です。 クレジット決済ご希望の方は、9月1日以降に決済用URLをお送りします。

そちらのURLより決済用ページにアクセスし、必要事項をご入力いただき、 お手続きください。

※請求書の到着をお急ぎの場合はご連絡ください。

※振込手数料は、貴社にてご負担願います。(クレジット決済の場合、手数料は協会で負担いたします。)

※また、お振込みいただいた参加費の返金はできませんので、欠席の場合は代理の方のご参加をお願いいたします。

※2018年10月2日(火)以降のキャンセルは受付けできません。

※懇親会不参加の場合も差額の返金等はございません。ご了承の程、よろしくお願いいたします。

※領収証の発行は、省略させていただいております。振込時に発行される控えをご利用ください。 別途、領収書の発行をご希望の方はお知らせください。





←こちらQRコードから も申込フォームに アクセスできます。

#### ◆◇◆プログラム◆◇◆

13:00~13:30 受付(五条の間)

13:30~13:35 開会挨拶

産学技術交流推進部門 マネジャー

岡山大学大学院 教授 後藤 邦彰 氏

13:35~14:25 講演1「膜を利用した微粒子分級技術を紹介します」

工学院大学 先進工学部 環境化学科 准教授 赤松 憲樹 氏

一 休憩(10分)—

14:35~15:25 講演2「微小粒子添加で粒子流動性を向上させよう!」

同志社大学 理工学部 化学システム創成工学科 准教授 吉田 幹生 氏

一 休憩(10分)—

15:35~16:25 講演3「粉体挙動を"見える化"したくないですか?」

大阪大学 工学研究科 機械工学専攻 准教授 辻 拓也 氏

一 休憩・会場移動 (15分) ―

16:40~18:25 懇親会 (嵯峨・貴船)

18:25~18:30 閉会挨拶

産学技術交流推進部門 副マネジャー

菅原精機株式会社 会長 菅原 一博 氏

問合せ先: 〒600-8716 京都市下京区烏丸通六条下ル北町181 第5キョートビル7階

一般社団法人日本粉体工業技術協会 事務局 青島 有美 TEL:075-354-3581 E-mail:sangaku@appie.or.jp